

인도의 정부
전자정보기술부
(IPHW 부서)

수정된전자제조클러스터계획(EMC 2.0):

1. 배경 및 목적:

국내 전자제품의 제조기반은 그러한 상품의 수요에 비해 극도로 부적절하다. 인도에서 제품을 생산하는 경우에도 국내 부가가치의 범위는 낮습니다. 제조업에 대한 투자를 유치하는 방법의 중요한 제약 중 하나는 산업의 성장과 지역 전체의 분산을 위한 신뢰할 수 있고 품질 좋은 인프라의 가용성이 부족하다는 것입니다. 국내에서 전자제품 제조의 산업화와 성장을 촉진하기 위해 정부는 2012 년 10 월에 전자제품 설계 및 제조(ESDM) 부문에 대한 투자 유치를 위한 세계적 수준의 인프라 구축을 지원하도록 전자제품 제조 클러스터계획(Electronic Manufacturing Clusters)을 통보했습니다. 이 계획은 2017 년 10 월부터 신청서를 접수하기 위해 폐쇄되었습니다. 이 계획의 영향과 전자 시스템, 설계 및 제조(ESDM) 부문의 성장을 위한 그러한 계획의 지속 필요성을 분석하기 위해, EMC 체계의 제 3 자 분석을 위한 독립 기관과 학제간 영향 평가 위원회를 통해 이 계획의 평가가 수행되었습니다. 업계를 포함한 모든 이해관계자의 고무적인 반응과 EMC 에서의 작업을 설정하려는 의도에 따라, 이 계획은 가치 사슬과 함께 전자 제품 제조의 기반을 창출하는 데 도움이 되는 역할을 수행하도록 권장되었습니다. 따라서, 글로벌 투자자와 국내 투자자를 모두 EMC 내에서 생산을 시작하도록 유도하기 위해 수정된 형태로 지속되어야 하며, 이는 다시 전자제품 제조 분야의 글로벌 가치 사슬과 더 큰 통합을 보장할 것입니다. 전자정보기술부는 "디지털 인도"와 "인도로 만들기" 이니셔티브에 따라 인도를 전자제조 허브로 만들기 위해 정부가 기울인 노력을 보완하기 위해 수정된 전자제조 클러스터(EMC 2.0) 계획을 도입할 것을 제안합니다.

1.2 이러한 EMC 는 전자제품설계와 생산(ESDM) 부문의 성장을 지원하고, 기업가적 생태계 개발을 돕고, 혁신을 추진하고, 분야에서 투자를 유치하고, 고용 기회와 세수를 늘려 지역의 경제성장을 촉진합니다.

2. 수정된전자제조클러스터계획 (EMC 2.0)

2.1 수정된 전자제조클러스터(EMC 2.0) 계획에 따라, 전자 제조 클러스터는 EMC 프로젝트의 공통 시설과 편의 시설을 갖춘 인프라를 만들고 전자 제조에 투자를 유치하기 위해 산업

인도의 정부
전자정보기술부
(IPHW 부서)

지역/공원/지역 인프라를 개선하기 위해 설립됩니다. 이 범위는 산업시행기관으로 준비할 타당성 조사 보고서를 통해 필요하고 확인된 구성 요소를 다룹니다.

2.2 재정 지원은 전자 제조 클러스터 (EMC) 및 공통 시설 센터 (CFC)를 설정하는 데 도움이 됩니다. 이 계획의 목적은 다음과 같습니다.

2.2.1 **EMC** 사업은 개발되지 않거나 미개발된 지리적 지역이 있으며, 특히 ESDM 유닛을 위한 기본 인프라, 생활 편의 시설 및 기타 공통 시설의 개발에 초점을 맞추고 있습니다.

2.2.2 공통 시설 센터(CFC) : 이 지역에는 기존 ESDM 유닛이 상당히 많이 위치되어 있어야 하며, 공통 기술 인프라를 개선하고 기존 EMC, 산업 지역/공원의 ESDM 유닛을 위한 공통 시설을 제공하는 데 중점을 두어야 합니다.

2.2.3 앵커 유닛은 EMC 에 전자제품 제조 시설을 설치하기 위해 제안된 EMC 프로젝트에서 판매 가능한/임대 가능한 토지 면적의 최소 20%를 구매하기로 약정한 전자제품 제조 회사이며, INR 300 크로어(39,215,700 USD) 이상의 투자를 약속합니다.

2.2.4 사업관리기관(PMA): PMP 는 인도 정부인 전자정보기술부(MeitY) 산하의 자치단체(Society 또는 PSU) 형태의 기관이 될 것입니다. 이러한 기관은 사업관리기관(PMA)로 활동하며, 비서, 관리 및 구현 지원을 제공하고 MeitY 가 수시로 할당한 기타 책임을 수행할 책임이 있습니다. PMA 의 기능과 책임은 MeitY 에서 별도로 발행하는 제도지침에 자세히 설명될 것입니다.

2.2.5 사업시행기관(PIA): PIA 는 PMA 에 프로젝트 신청서를 제출하는 기관이 될 것입니다. 이 계획에 따른 신청은 주 정부 또는 국가시행 기관(SIA) 또는 중앙 공공 부문 단위(CPSU) 또는 주 공공 부문 단위(PSU) 또는 DMICDC 와 같은 산업 코리더 개발공사(ICDC)에서 할 수 있습니다. (경우에 따라). PMA 에서 신청서를 제출하는 기관은 사업시행기관(PIA)로 불립니다.

2.2.6 사업심사위원회(PRC): PRC 는 전자정보기술부(MeitY)가 제도에 따른 승인 신청서를 고려하여 공동장관급 이하 임원을 위원장으로 구성되는 위원회입니다. PRC 는 다른 부처/부서 및 조직의 대표자로 구성될 것입니다. PRC 는 EMC 2.0 계획에 따라 신청서의 승인/거부를 위해 PMA 에 권장합니다. PRC 는 승인된 프로젝트의 진행 상황도 검토합니다. PRC 회의는 때때로

인도의 정부
전자정보기술부
(IPHW 부서)

그리고 필요할 때 언제든지 소집됩니다. PRC 의 세부적인 헌법, 기능 및 책임은 제도지침에 자세히 설명될 것입니다.

2.2.7 집행이사회(Governing Council): GC 는 전자정보기술부(MeitY, MeitY)가 위원장으로 구성하는 위원회입니다. GC 는 정부와 업계의 전문가들로 구성될 것입니다.GC 는 정기적으로 제도의 진행 상황과 그 프로젝트의 진행 상황을 검토합니다. GC 는 계획의 성공적인 구현을 위해 수시로 제도지침의 개선/수정 권한을 갖습니다. GC 의 세부적인 헌법, 기능 및 책임은 제도 지침에 자세히 설명될 것입니다.

2.3 신청 방식 및 자격 기준(Mode of application and eligibility criteria): EMC 2.0 계획에 따른 신청서는 주 정부 또는국가시행 기관(SIA)이나 중앙 공공 부문 단위(CPSU), 주 공공 부문 단위(SPSU) 또는 DMICDC 등과 같은 산업 코리더 개발 공사(ICDC)가 사업시행기관(PIA)의 역할과 책임을 명확히 언급하는 내용과 함께 PMA 에 제출합니다. 중앙 공공 부문 단위(CPSU) 또는 주 공공 부문 단위(SPSU)의 경우에, 신청서는 관련 중앙 정부 또는 주 정부(행정 부처 또는 부서)의 권고 사항과 함께 제출됩니다.

EMC 2.0 계획에 따른 신청서는 다음 사항을 준수해야 합니다.

- I. EMC 프로젝트의 경우, Anchor Unit 또는 업계에서 판매 가능한/임대 가능한 토지 면적의 최소 20%를 인수(구매 또는 임대)하기로 약속하고 최소 Rs.300 Crore(39,215,700 USD)의 투자 계약을 체결해야 합니다.
- II. 토지구획는 200 에이커 되어야 합니다.
- III. 모든 북동부, 언덕 주 및 UT 에 필요한 토지구획는 100 에이커 되어야 합니다. 이 지역에서 프로젝트에 대한 최소 투자 약속은 INR 150 Crore(19,607,800 USD)가 될 것입니다.
- IV. 제안된 토지구획는 PIA 를 소유해야 하며 가급적 인접해야 합니다.
- V. 반경 1/2Km 이내의 최대 2 개의 토지 구획은 인접한 것으로 간주됩니다. 도로를 가로지르는 토지 구획도 인접한 것으로 간주될 것입니다.

인도의 정부
전자정보기술부
(IPHW 부서)

- VI. EMC Scheme 에 따른 기존 클러스터가 확장을 위해 사용되고 인접 토지가 EMC 2.0 Scheme 에 따라 개발될 것을 제안합니다. 기존 제조 단위가 있는 토지도 토지구획의 일부로 간주됩니다. 이는 기존 EMC 에서 판매 가능한/임대 가능한 토지의 80%가 제조 장치에 할당되어야 하고 토지가 할당된 장치의 최소 50%가 생산 활동을 시작했어야 한다는 조건이 적용됩니다. 이 경우, 토지 요건에 대한 다음과 같은 조건이 적용됩니다:
- a) 기존 EMC 와 인접해 있는 최소 100 에이커의 토지 구획은 이 계획에 따른 신청에 필요한 최소 토지 요건을 충족하기 위해 고려될 것입니다.
 - b) 모든 북동부, 힐 스테이트 및 UT 의 경우, 기존 EMC 와 인접해 있는 최소 50 에이커의 토지 구획은 이 계획에 따른 신청에 필요한 최소 토지 요건을 충족하기 위해 고려될 것입니다.
- 이 경우에, EMC 2.0 계획에 따라 제안된 새로운 지역만 재정적 지원을 받을 수 있습니다.
- VII. 제안된 토지 구획은 번호가 매겨지지 않고 산업용으로 사용되어야 합니다.
- VIII. CFC(Common Facility Centre)의 경우, 시설의 사용자로 식별되는 최소 5 개의 전자 제조 장치가 있어야 합니다.
- IX. 사업시행기관(PIA)는 수정된 전자제조클러스터(EMC) 내에서 판매 가능한/임대 가능한 토지의 최소 10%에 있는 레디-빌트 공장 격납고작업장(Ready Built Factory Sheds)/ 플러그 앤 플레이(Plug & Play) 시설을 제공합니다.

3. 재정 지원(Financial Assistance): 공동 시설과 생활 편의 시설과 함께 세계적인 수준의 인프라 조성을 위한 재정지원이 이뤄질 것입니다. 재정적 지원은 전자 제조 클러스터(EMC) 및 공통 시설 센터에서 다음과 같이 제공됩니다:

3.1 EMC 프로젝트의 경우, 100 에이커의 토지에 대해 INR 70 크로어(9,150,330 USD)의 상한에 따라 프로젝트 비용의 50%로 재정 지원이 제한됩니다. 더 큰 지역의 경우, 프로-레이타 천장이 적용되지만 프로젝트 당 350 크로어(45,751,600 USD)를 초과하지 않습니다. 나머지 프로젝트 비용은 주 정부 또는 주 정부 구현 기관(SIA) 또는 중앙 공공 부문 단위(CPSU) 또는 주 공공 부문 단위(PSU) 또는 DMICDC 와 같은 산업 코리더 개발 공사(ICDC)가 수집하며, 프로젝트 비용의 최소 50%를 기부합니다.

인도의 정부
전자정보기술부
(IPHW 부서)

3.2 공통 시설 센터(CFC) 의 경우, 재정적 지원은 Rs.75 크로어(9,803,920 USD)의 상한에 따라 프로젝트 비용의 75%로 제한됩니다. 나머지 프로젝트 비용은 주 정부 또는 주 정부 구현 기관(SIA) 또는 중앙 공공 부문 단위(CPSU) 또는 주 공공 부문 단위(PSU) 또는 DMICDC 와 같은 산업 코리더 개발 공사(ICDC)가 수집하며, 프로젝트 비용의 최소 25%를 기부합니다.

4. EMC 2.0 계획에 따른 모든 재정 지원 제안은 전자 및 정보 기술부 (MeitY) 가 구성하는 사업심사위원회 (PRC)에서 검토해야 합니다. PRC 는 MeitY 에서 공동 비서 직급 이하의 담당자가 맡고 다른 부처/부서 및 조직의 대표자로 구성됩니다. PRC 는 EMC 2.0 계획에 따라 신청서의 승인/거부를 위해 PMA 에 권장합니다. PRC 는 승인된 프로젝트의 진행 상황도 검토합니다. PRC 의 세부적인 헌법, 기능 및 책임은 제도지침에 자세히 설명될 것입니다.

5. EMC 2.0 계획에 따른 적용 대상 활동 목록이 (별첨로) 첨부되어 있습니다.

6. EMC 프로젝트 준비, 평가 및 자금 방출

6.1 PIA 가 PMA 에 제출한 프로젝트 신청서에는 특정 EMC 프로젝트에 대한 인프라 요구사항 및 공통 시설의 세부 사항이 포함되어야 합니다. 또한 프로젝트 제안서에는 EMC 의 성장 잠재력에 대한 데이터, 조사, 예측 및 타당성 가능성이 포함되어야 합니다. PIA 는 Anchor 유닛, R&D 기관, 금융 기관, 주 정부 등과 같은 기관의 지원을 필요할 때마다 적극적으로 참여시킬 수 있습니다.

6.2 PMA 는 전문 컨설팅 기관 또는 금융 기관의 도움을 받아 신청서를 평가합니다. PMA 는 사업심사위원회의 검토를 위해 프로젝트의 평가 보고서를 제출할 것입니다. PRC 는 프로젝트의 승인/거부에 대한 동의를 위해 PMA 에 권고합니다.

6.3 PMA 는 PRC 의 권고에 따라 프로젝트에 대한 승인을 발급하기 위해 DFPR(금융권력규칙 위임)에 따라 관할 기관으로 부터 필요한 승인을 받습니다. PMA 의 기능과 책임은 제도지침에 자세히 설명될 것입니다.

6.4 EMC 의 선택/위치는 PIA 가 앵커 유닛/산업과 협의하여 담당해야 합니다.

인도의 정부
전자정보기술부
(IPHW 부서)

7. **자금 방출:** 자금방출은 프로젝트별로, 그리고 Pari-passu 기준으로 하며, 다음과 같은 방법으로 3 개의 분할로 발행하는 것이 제안됩니다

7.1 프로젝트의 승인에 따라 선불로 30%의 첫번째 불입금이 출시됩니다.

7.2 40%의 두 번째 불입금은 첫 번째 불입금을 이용과 인프라 개발 및 앵커 유닛에 대한 토지분할과 관련된 달성을 후 출시됩니다.

7.3 프로젝트는 완료 후 30 %의 세 번째불입금은 출시됩니다.

7.4 자금은 PIA 가 지정된 계좌 또는 관련 주정부 또는 부처/부서(사례에 따라)에 pari-passu 기여금을 입금한 후 PMA 를 통해 PIA 에 공개됩니다. PIA 의 내부 발생이나 은행 또는 금융 기관(FI)의 자금 지원이 있을 경우, 해당 자금은 지정된 계좌로 이전되어야 합니다.

8. 구현 메커니즘

8.1 이 계획은 인도 정부인 전자정보기술부(MeitY) 산하의 자치단체(사회 또는 PSU) 형태로 기관을 통해 시행됩니다.이러한 기관은 사업관리기관(PMA)로 활동하며, 비서, 관리 및 구현 지원을 제공하고 MeitY 가 수시로 할당한 기타 책임을 수행할 책임이 있습니다. PMA 의 기능과 책임은 MeitY 에서 별도로 발행하는 제도지침에 자세히 설명될 것입니다.

8.2 MeitY 는 이 계획에 따라 승인된 프로젝트에 대한 예산 규정을 제정해야 합니다. PMA 는 프로젝트별 요구 의 세부 사항과 함께 예산요구 사항을 정기적으로 MeitY 에 제출합니다. 승인된 프로젝트를 위해 PMA 에 의해 PIA 에 재정 지원이 제공됩니다.

9. **계획/프로젝트 감시:** 이계획의 진행 상황은 MeitY 사무국장이 주재하는 MeitY 가 구성할 집행이사회(GC)를 통해 검토될 것입니다. GC 는 정부와 업계의 전문가들로 구성될 것입니다.GC 는 정기적으로 제도의 진행 상황과 그 프로젝트의 진행 상황을 검토합니다. GC 는 제도의 성공적인 구현을 위해 제도 지침의 개정을 수시로 수행할 수 있습니다.GC 의 세부적인 헌법, 기능 및 책임은 S 제도 지침에 자세히 설명될 것입니다.

10. 제도의 임기:

인도의 정부
전자정보기술부
(IPHW 부서)

이 계획은 통지일로 부터 3 년 동안 신청서를 받을 수 있도록 개방됩니다. 승인된 프로젝트에 자금을 지출할 경우 5 년의 추가 기간을 사용할 수 있습니다. 이 계획에 따라 접수된 신청서는 지속적으로 평가됩니다.

11. 전자 정보 기술부는 이 계획의 실행을 위한 지침을 발행할 것입니다. 계획 지침의 수정 권한은 MeitY 가 설정할 계획 이사회에 있습니다.

12. MeitY 는 EMC 2.0 계획에 따른 계획 및 프로젝트의 진행 상황을 정기적으로 감시하고 검토합니다.

13. MeitY 는 통보일로부터 3 년 후 계획에 대한 중간 평가를 수행하고, 필요에 따라 계획의 성공적인 이행을 위해 수정/개정을 제안합니다. 계획 기간이 종료된 후 이러한 중간 평가및 다른 평가를 수행하기 위해 독립 기관의 서비스를 이용할 것입니다.

EMC 2.0 계획의 별첨

EMC 2.0 계획에 따른 적용 대상 활동의 예시 목록

A. 중요한 서비스

- I. 경계벽
- II. 내부 도로
- III. 폭풍우 배수구
- IV. 전기 변전소 / 배전망

B. 필수적인 서비스

- I. 폐기물 처리 / 재활용
- II. 순환여과식/ 정수 처리장
- III. 폐수처리공장
- IV. 하수도

인도의 정부
전자정보기술부
(IPHW 부서)

- V. 전자폐기물 관리
- VI. 가로등
- VII. 백업 발전소
- VIII. 창고업
- IX. 레디-빌트 공장 격납고작업장(Ready Built Factory Sheds)/ 플러그 앤 플레이 시설
- X. 화재와 안전 서비스

C. 바람직한 서비스

1. 복지 서비스

- I. 직원 호스텔
- II. 병원과 ESIC
- III. 놀이 시설/놀이장
- IV. 보육 시설/ 탁아소
- V. 교육 시설
- VI. 은행 및 금융 서비스

2. 지원 서비스

- I. 우수 센터(연구 개발(R&D), 배양 서비스 및 상담 서비스)
- II. 기술 개발 센터/훈련 시설
- III. 강당 및 회의 시설
- IV. 화상 회의 시스템, 정보 기술 및 텔레콤 기반시설
- V. 산업, 무역 및 컨벤션 센터

3. 제조 지원

- I. 공구실
- II. 컴퓨터 이용 설계(CAD) / 컴퓨터 이용 제조(CAM) 디자인 하우스

인도의 정부
전자정보기술부
(IPHW 부서)

III. 플라스틱 성형 / 캐비닛 제조

IV. 판금 스탬핑

V. 포장 / 에폭시 공급업체

VI. 검사설비 및 인증 시설

VII. 부품 검사:

a) 안전, 수명 검사, 신뢰성/환경, 전기 및 기계적 특성

b) 유해물질 제한지침(RoHS) 검사

c) 전자파검사(EMI)/전자기(EMC)검사

d) CRO 준수